



会议邀请函

尊敬的_____先生/女士:

“中国材料大会2021”于2021年7月8-12日在福建省厦门市召开，会议由中国材料研究学会发起并主办。分会场合和论坛设置如下:

A. 能源材料

- A01. 能源转换与存储材料
- A02. 热电材料及应用
- A03. 核材料
- A04. 太阳能材料与器件
- A05. 油气田材料
- A06. 氢能与燃料电池关键材料

B. 环境材料

- B01. 光催化材料
- B02. 生态环境材料
- B03. 环境工程材料
- B04. 资源材料与循环利用

C. 结构材料

- C01. 粉末冶金
- C02. 高性能铝合金
- C03. 镁及镁合金
- C04. 高温合金
- C05. 高性能钛合金材料
- C06. 金属基复合材料
- C07. 空间材料科学技术
- C08. 高温结构材料与防护涂层
- C09. 先进无机材料
- C10. 纳米、异构和梯度材料

D. 功能材料

- D01. 超材料与多功能材料
- D02. 多铁性材料
- D03. 非晶与高熵合金
- D04. 极端条件材料与器件
- D05. 功能分子材料与器件
- D06. 先进微电子与光电子材料

- D07. 生物医用材料
- D08. 多孔金属材料
- D09. 纤维材料改性与复合技术
- D10. 高分子材料
- D11. 超导材料与应用技术
- D12. 纳米与磁光电功能材料
- D13. 水凝胶材料
- D14. 碳点功能材料
- D15. 纳米发电机与压电电子学
- D16. 矿物功能材料
- D17. 先进电子与智能传感功能材料
- D18. 石墨烯的现状与未来
- D19. 液态金属材料
- D20. 多孔吸附与催化
- D21. 医药智能材料与技术
- D22. 多尺度光电材料及器件

E. 材料设计、制备与评价

- E01. 材料先进制备加工技术
- E02. 材料界面/表面分析与表征
- E03. 相分离冶金与材料
- E04. 先进凝固科学与技术
- E05. 材料服役行为与结构安全
- E06. 材料基因组
- E07. 增材制造材料
- E08. 超声材料科学与技术
- Z. 材料模拟、计算与设计

F. 论坛

- FB. 粤港澳大湾区新能源材料与器件学术论坛
- FE. 材料教育论坛

中国材料大会2021 CHINESE MATERIALS CONFERENCE 2021



时间 / TIME
2021年7月8-12日 July 8-12, 2021

地点 / VENUE
福建·厦门 Xiamen, Fujian

注册费标准及付款方式（不含版面费，食宿统一安排，费用自理）：

2021年6月8日（含8日）前注册交费	非学生：RMB 2000元 学 生：RMB 1000元
2021年6月8日后注册交费	非学生：RMB 2500元 学 生：RMB 1500元
现场交费	非学生：RMB 2800元 学 生：RMB 1800元

注：缴费日期以银行印鉴为准。

付款方式1：在线支付

请登录会议网站，注册后进行在线支付。

付款方式2：网银汇款

账户名称： 中国材料研究学会
开户银行： 中国工商银行紫竹桥支行
银行帐号： 0200 2355 1920 1069 811

欢迎从事材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、学生、政府有关的管理部門和领导、企业家及其它相关人员参会。

会议注册及提交稿件等信息，详见会议网站 <https://cmc2021.scimeeting.cn>。

